

# B<sup>2</sup>itプリント配線板

## 【概要】

B<sup>2</sup>it（ビースクエアイト）プリント配線板は層間の接続を銀ペーストバンプによって行うビルドアッププリント配線板です。

B<sup>2</sup>itプリント配線板により、システムのさらなる軽薄短小化が実現できます。非常にシンプルなプロセスのため、信頼性の高い製品をリーズナブルな価格でご提供することが可能です。

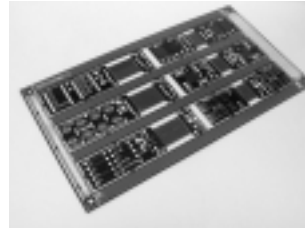
リジットフレックスタイプや部品内蔵タイプをラインアップに加え、更なる発展を遂げております。

## 【構造】

(1) 1+N+1、2+N+2、3+N+3構造のビルドアッププリント配線板の提供が可能です。

(2) 全ての層をビルドアップ構造にした All B<sup>2</sup>itプリント配線板の提供が可能です。

(3) コア材にフレックス配線板を用いたリジットフレックスB<sup>2</sup>itプリント配線板の提供が可能です。



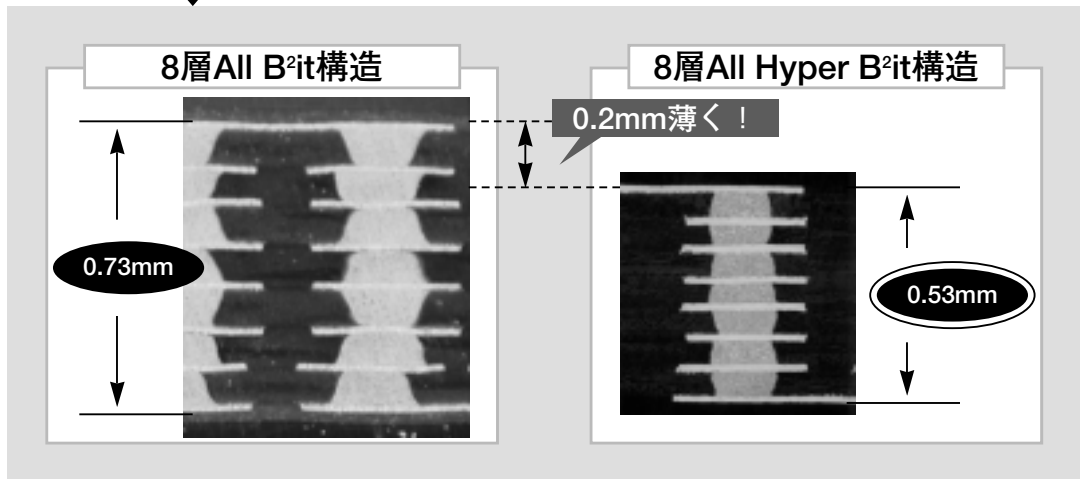
リジットフレックス  
B<sup>2</sup>itプリント配線板

(4) 基板内部にチップ部品を埋め込んだ部品内蔵B<sup>2</sup>itプリント配線板の提供が可能です。

## 【特徴】

- ① 任意の層の任意の位置にビアを形成すること（ランダムビア）が可能です。
- ② ビア上にビアを形成するスタックドビアの形成が可能です。
- ③ 絶縁材料は任意に選択可能ですので、ハロゲンフリー材料や高周波対応材料を用いたビルドアップ基板を実現することができます。
- ④ 電気的特性に大変優れています。

※0.4mmピッチCSP実装に対応した  
“Hyper B<sup>2</sup>it”を開発しました



**DT** CIRCUIT  
TECHNOLOGY

ディー・ティー・サーキットテクノロジー株式会社

〒183-8511

東京都府中市東芝町1番地 (株)東芝 府中事業所内3005号館

TEL : 042-362-1072

FAX : 042-362-1070

<http://www.dtct.co.jp/>

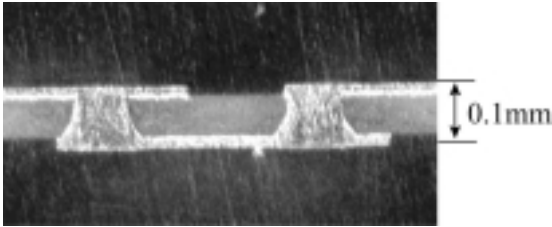
# パッケージ用 B<sup>2</sup>itプリント配線板

## 【概要】

システム用のB<sup>2</sup>itプリント配線板の技術を応用し、薄型化・小型化するインターポーザ配線板を開発しました。

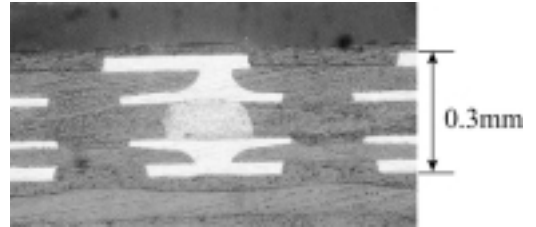
### <2層板タイプ>

ガラスエポキシ基材を用い、総厚0.1mmを実現しました。このことにより、チップスタックタイプのインターポーザとしての適用も可能となります。



### <4層板タイプ>

総厚0.3mm以下の薄型・多層化が可能です。ランダムビアを用いることでダイサイズパッケージが実現できます。



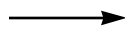
## 【構造】

- (1) 2層・4層のランダムビアタイプのインターポーザの提供が可能です。
- (2) メッキレスによるファインパターンの形成が可能です。

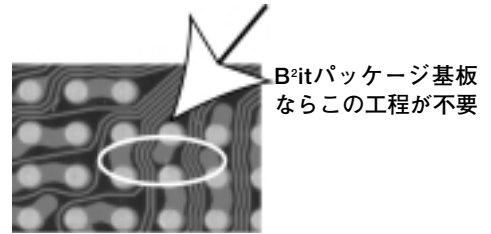
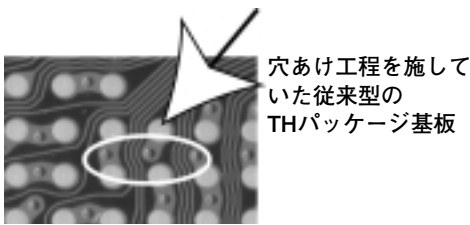
- (3) パッケージ間を bumps にて接続することで、パッケージスタックタイプのMCPへの対応が可能です。

## 【特徴】

- ① 穴あけ及び穴埋め工程、蓋メッキが不要



Pad on Via構造が低コストで可能



- ② メッキ工程が不要 → ファインパターンの形成が可能

工程短縮による低コスト・短納期対応が可能

- ③ 基材の薄板化に対応 → 基板総厚0.1mm (2層板) / 0.30mm (4層板) 以下にも対応可能

# DT CIRCUIT TECHNOLOGY

ディー・ティー・サーキットテクノロジー株式会社

〒183-8511

東京都府中市東芝町1番地 (株)東芝 府中事業所内3005号館

TEL : 042-362-1072

FAX : 042-362-1070

<http://www.dtct.co.jp/>